

# Einladung



**Schweizerische Gesellschaft  
für Oberflächentechnik  
Société Suisse de Traitement  
de Surface**

## ZUM TRADITIONELLEN SGO- LEITERPLATTENSEMINAR

Wir freuen uns sehr, Sie zum diesjährigen traditionellen SGO Leiterplattenseminar einzuladen. Ein abwechslungsreicher Nachmittag mit spannenden Vorträgen zu aktuellen Themen erwartet Sie.

Im Namen des OK's wünschen wir allen Beteiligten eine interessante und spannende Veranstaltung mit vielen Kontakten und wertvollen Anregungen im Kreise der Schweizerischen und Süddeutschen Leiterplatten-Familie.

Datum: Donnerstag, 29. September 2022

Beginn: 13:30h

Ort: Tagungszentrum Uediker-Huus  
im Spilhöfler  
CH-8142 Uitikon ZH  
(Parkplätze sind genügend vorhanden)

Kosten: Mitglieder CHF 70.00  
Nichtmitglieder CHF 110.00  
(Zahlung nur mit Bargeld möglich)

Im Preis inbegriffen sind Kaffee, Apéro + Nachtessen (ohne Getränke)

Anmeldung: [www.sgo-sst.ch](http://www.sgo-sst.ch) – Fachanlässe  
bis spätestens: 15. September 2022

# Programm

- 13:30 Uhr ***Begrüssung***  
Peter Weber, VR-Präsident Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft;  
ehem. Head of Technology GS Swiss PCB AG, CH-Küssnacht
- Marktanalyse Europa (speziell D / A / CH)***  
Remo Fischer, Betriebsleitung Hofstetter PCB AG, CH-Küssnacht
- 13:45 Uhr ***Von Qualitätskontrolle zu Predictive Maintenance –  
AI revolutioniert die Industrie***  
Philipp Schmid, Head Research and Business Development, CSEM CH
- AI setzt sich immer stärker im Alltag durch: Übersetzungsprogramme, lustige Fotofilter auf dem Handy oder Fahrassistenzen im Auto. Nun steht der grosse Durchbruch in der produzierenden Industrie an. Perfekte Qualität und immer höhere Effizienz treiben Schweizer Firmen. Mit neuen Konzepten wie Predictive Quality stehen ganzheitliche Lösungsansätze zur Verfügung welche auch eine direkte Wertschätzung mitbringen. Philipp Schmid analysiert im Referat wo die Technologie heute steht, er weist auf Stolpersteine hin und zeigt anhand von konkreten Beispielen das enorme Potential von AI in der Industrie.
- 14:30 Uhr ***Disruptive Lieferketten –  
Eine Einschätzung aus transporttechnischer Sicht***  
Markus Widmer, Head of Ocean Freight Switzerland und Head of Fairs,  
Events and Special Logistics Switzerland, Schenker Switzerland Ltd.
- Vor 2.5 Jahren geriet die Globale Supply Chain aus den Fugen. Transportsysteme auf den Weltmeeren und zu Luft funktionieren plötzlich nicht mehr. Der Flächenbrand macht auch vor Europa nicht Halt und es herrscht akuter LKW und Fahrermangel. Wo liegen die Ursachen und hätte man das voraussehen können? Welche Beschaffungs- und Distributionsstrategien bieten sich an und wann ist wieder mit Normalität zu rechnen?
- 15:15 Uhr ***Die neue Medical Device Regulation (MDR) -  
Regulatorische Herausforderung für Medizinproduktehersteller und  
Auswirkungen auf Zulieferindustrie***  
Benno Uennigmann, BIOTRONIK SE & Co. KG, Berlin, Deutschland
- Die neue europäische Medizinprodukteverordnung „MDR“ stellt Medizinproduktehersteller vor große Herausforderungen. So bindet die Erfüllung der Anforderungen für Bestandsprodukte Ressourcen, welche dann nicht mehr für Neuentwicklungen zur Verfügung stehen und viele Produkte müssen sogar vom Markt genommen werden. Zur Erfüllung der gestiegenen Dokumentationsanforderungen werden Hersteller von Medizinprodukten zudem deutlich

umfangreichere Anforderungen an ihre Lieferanten stellen müssen und Dokumente in ungewohntem Detailgrad benötigen. Der Vortrag gibt einen Überblick über die neuen Anforderungen für Medizinproduktehersteller und mögliche Auswirkungen auf deren Lieferanten.

16:00 Uhr **Pause**

16:30 Uhr **mSAP**

Matthias Hampel, Schlötter Galvanotechnik

SLOTOGO-IT 1 (mSAP) – Blind-Microvia Filling mit sehr geringer Oberflächenschichtdicke mit anschließendem Patternplating Schritt –  
Der SLOTOGO-IT 1-Prozess ist ein dreistufiger Prozess der speziell für den mSAP entwickelt wurde. Durch ein innovatives Direktmetallisierungsverfahren auf Basis von reduziertem Graphendioxid als leitende Startschicht können insbesondere HF Materialien beschichtet werden. Mit einem neuen Filling Verfahren ist es möglich Blind-Microvias mit einer sehr geringen Oberflächenschichtdicke zu füllen. Für die Strukturierung im abschließenden Pattern Plating Schritt bietet ein RPP Verfahren eine sehr gleichmäßige und strukturge-treue Kupferabscheidung. Der SLOTOGO-IT 1-Prozess wird im Bereich der 5G Technologie Anwendung finden.

17:15 Uhr **Keynote: Leadership Lektion aus dem Extremsport**

Dani Arnold, Extremsportler

Der weltbeste Bergsteiger der Gegenwart über Gefahr, Adrenalin und Entscheidungsfindung

18:00 Uhr **Schlusswort**

18:05 Uhr **Apéro mit anschließendem Nachtessen**

und gemütlichem Beisammensein